

2025年3月期 第3四半期  
決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2025年2月10日

## 【連結会計期間】

日本国内(1社)：4月～12月／海外(10社)：1月～9月

### ● 表面処理用資材事業

- 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品の需要は緩やかな回復基調で推移した。また、為替相場の円安による効果も寄与し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を上回った。

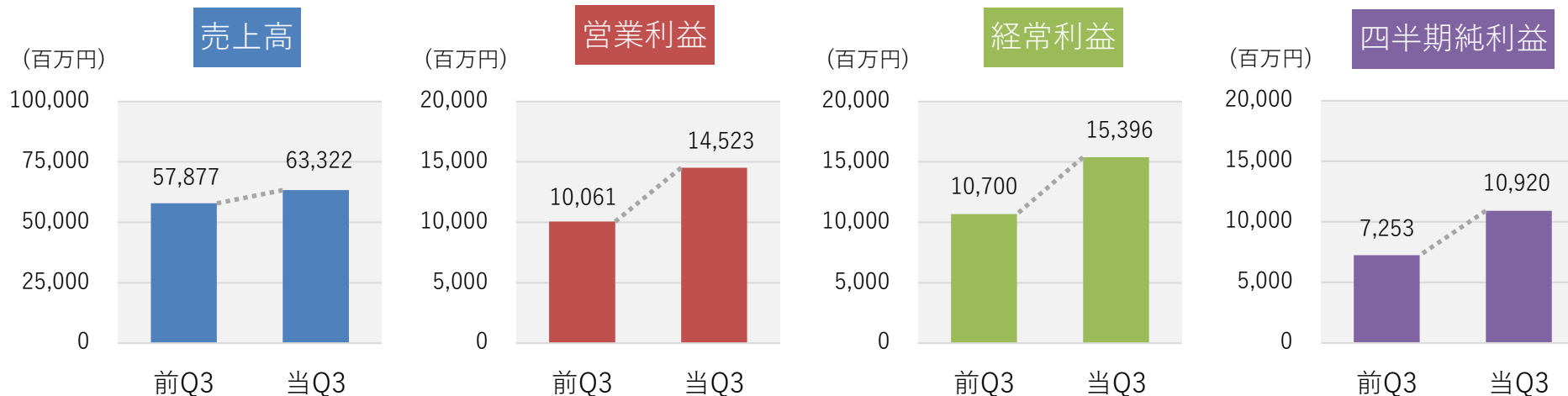
### ● 表面処理用機械事業

- パッケージ基板メーカーによる設備投資が一巡したことから、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を下回った。

### ● めっき加工事業

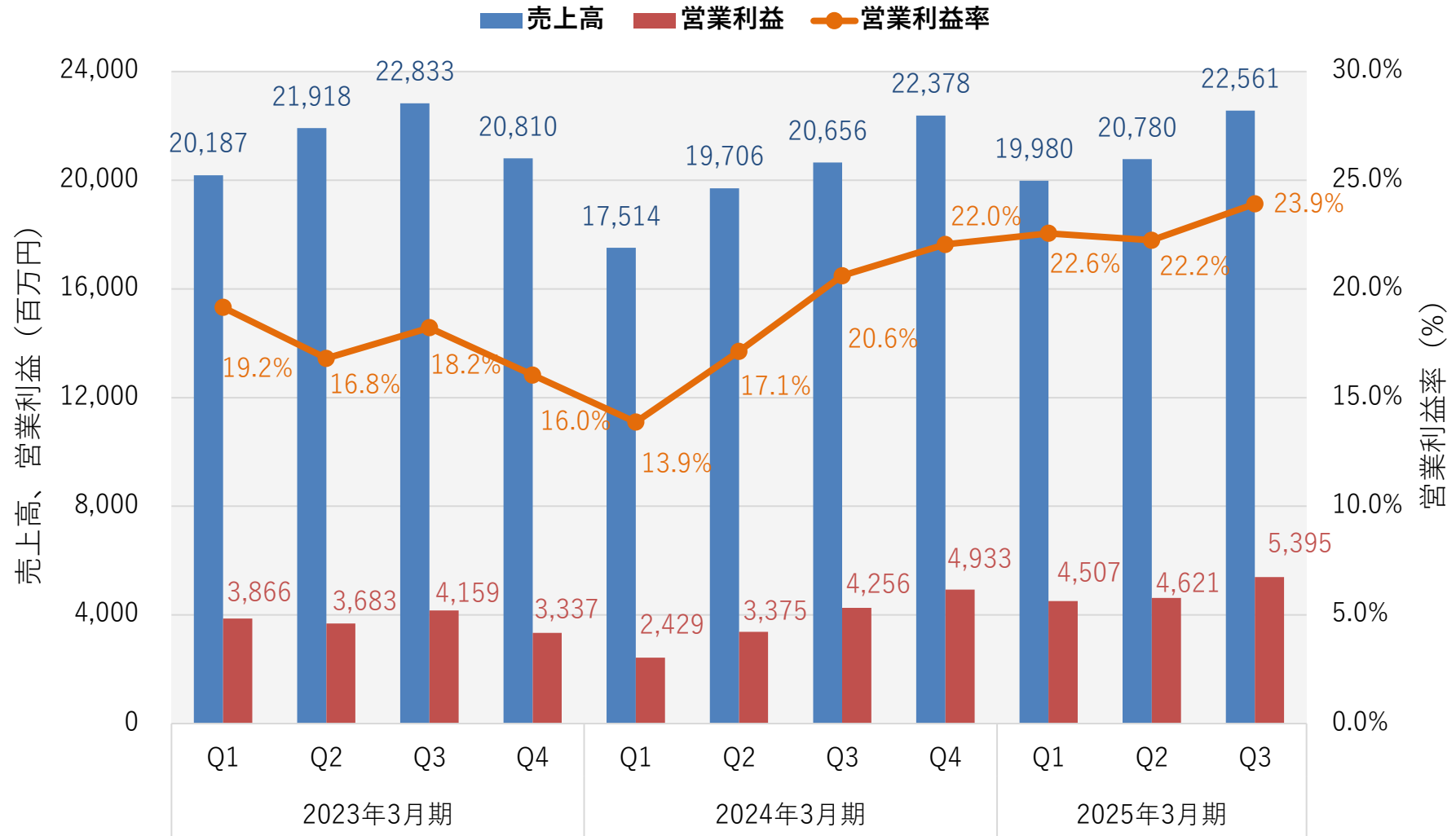
- 自動車部品向けのめっき加工の需要が低調に推移し、売上高は前年同四半期を下回ったが、コスト削減や歩留まりの改善に取り組んだことから、セグメント損失は前年同四半期より改善した。

# 2025年3月期 第3四半期 決算概要

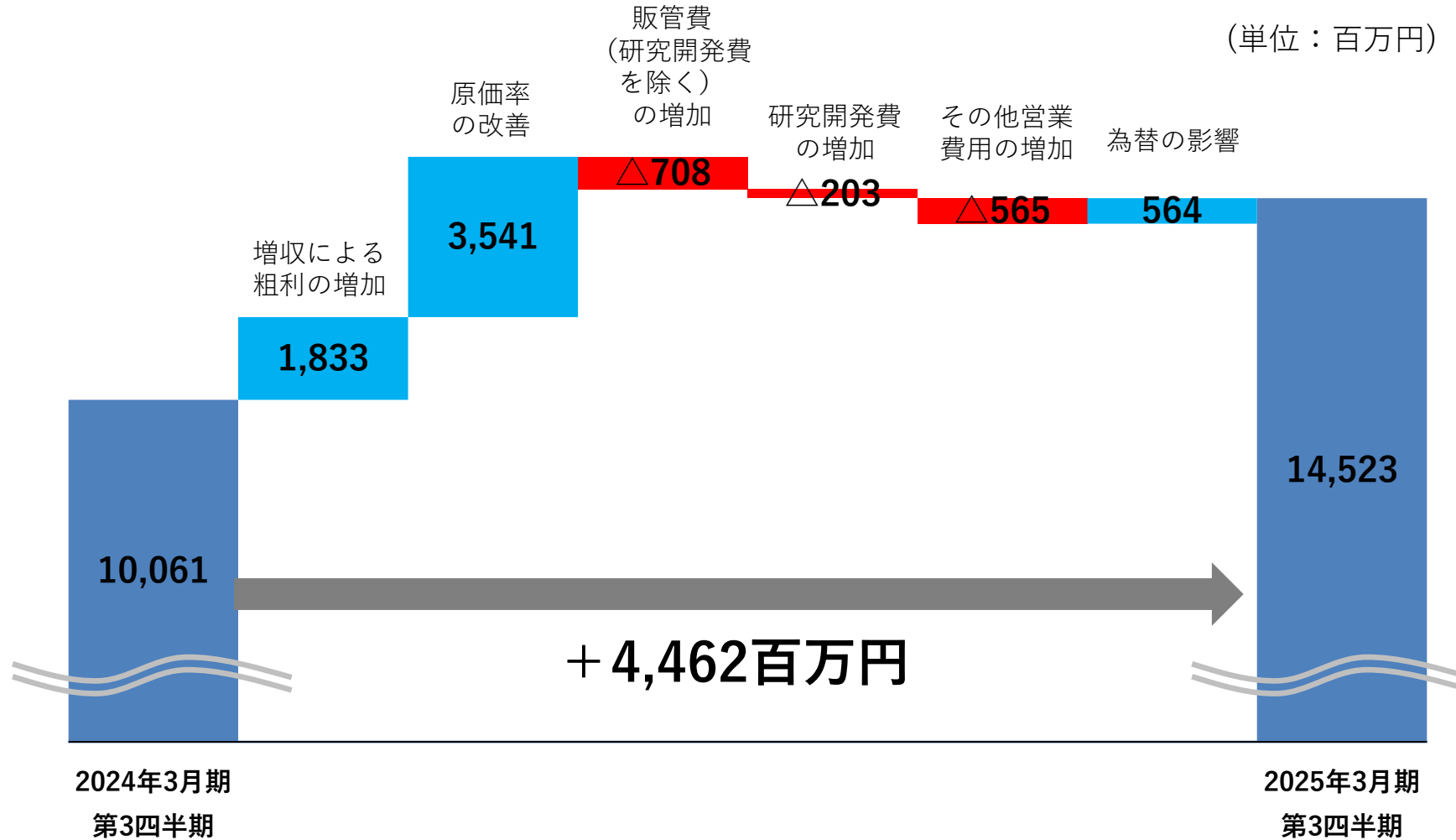


(単位：百万円)	前第3四半期 累計実績	当第3四半期 累計実績	増減額	増減率
売上高	57,877	63,322	+ 5,445	+ 9.4%
営業利益	10,061	14,523	+ 4,462	+ 44.3%
経常利益	10,700	15,396	+ 4,696	+ 43.9%
四半期純利益	7,253	10,920	+ 3,667	+ 50.6%
為替：米ドル	138.24円	151.46円	13.22円安	

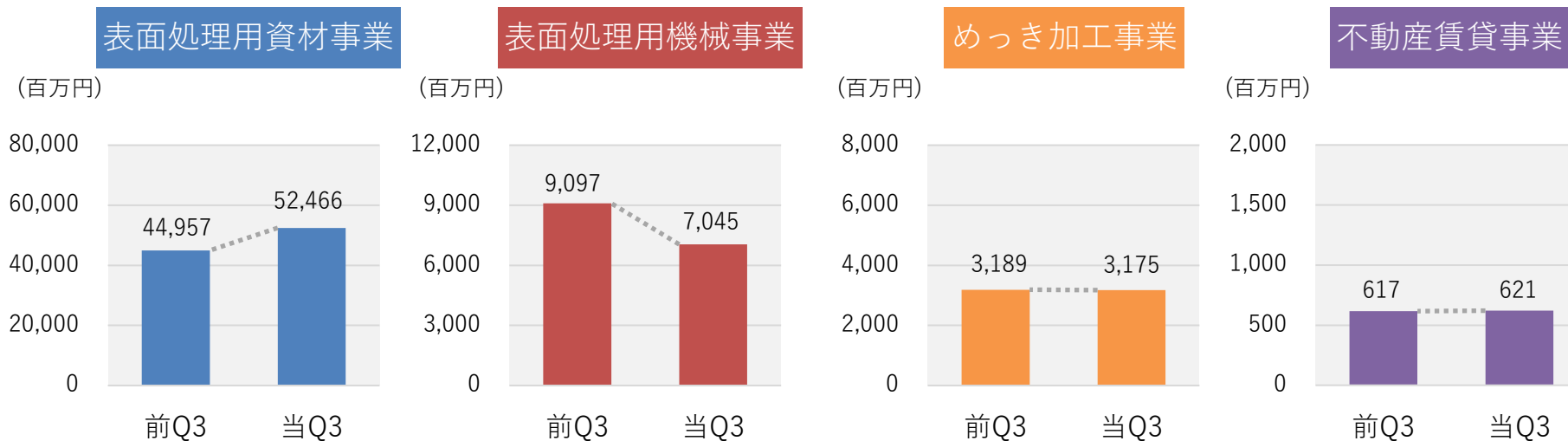
# 四半期毎の業績推移



# 営業利益の増減要因



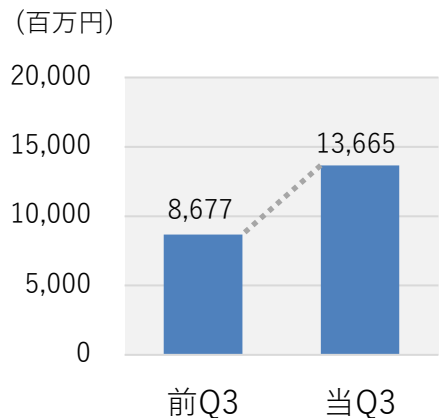
# 事業セグメント別売上高



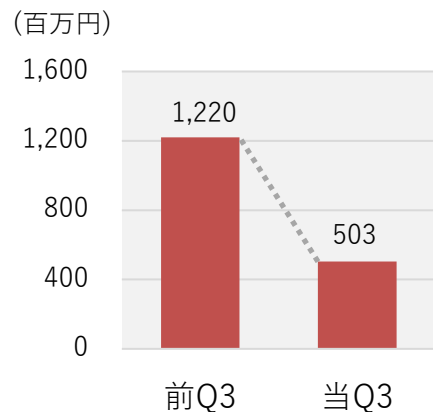
(単位：百万円)	前第3四半期 累計実績	当第3四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	44,957	52,466	7,509	16.7%
表面処理用機械	9,097	7,045	△ 2,052	△ 22.6%
めっき加工	3,189	3,175	△ 14	△ 0.4%
不動産賃貸	617	621	4	0.6%

# 事業セグメント別営業利益

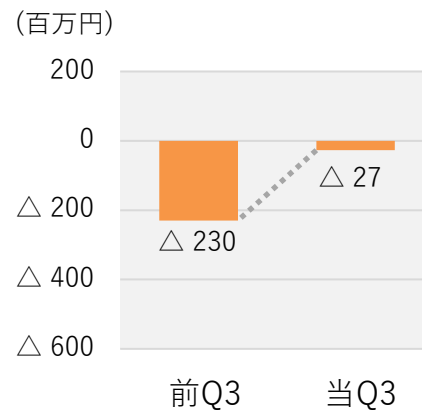
表面処理用資材事業



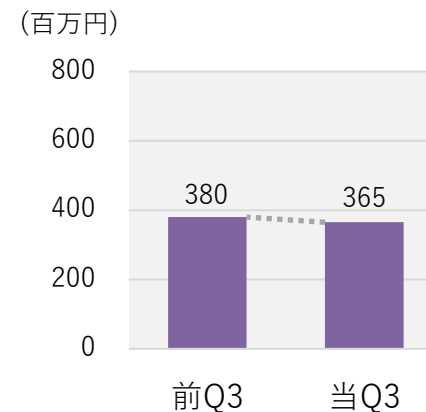
表面処理用機械事業



めっき加工事業

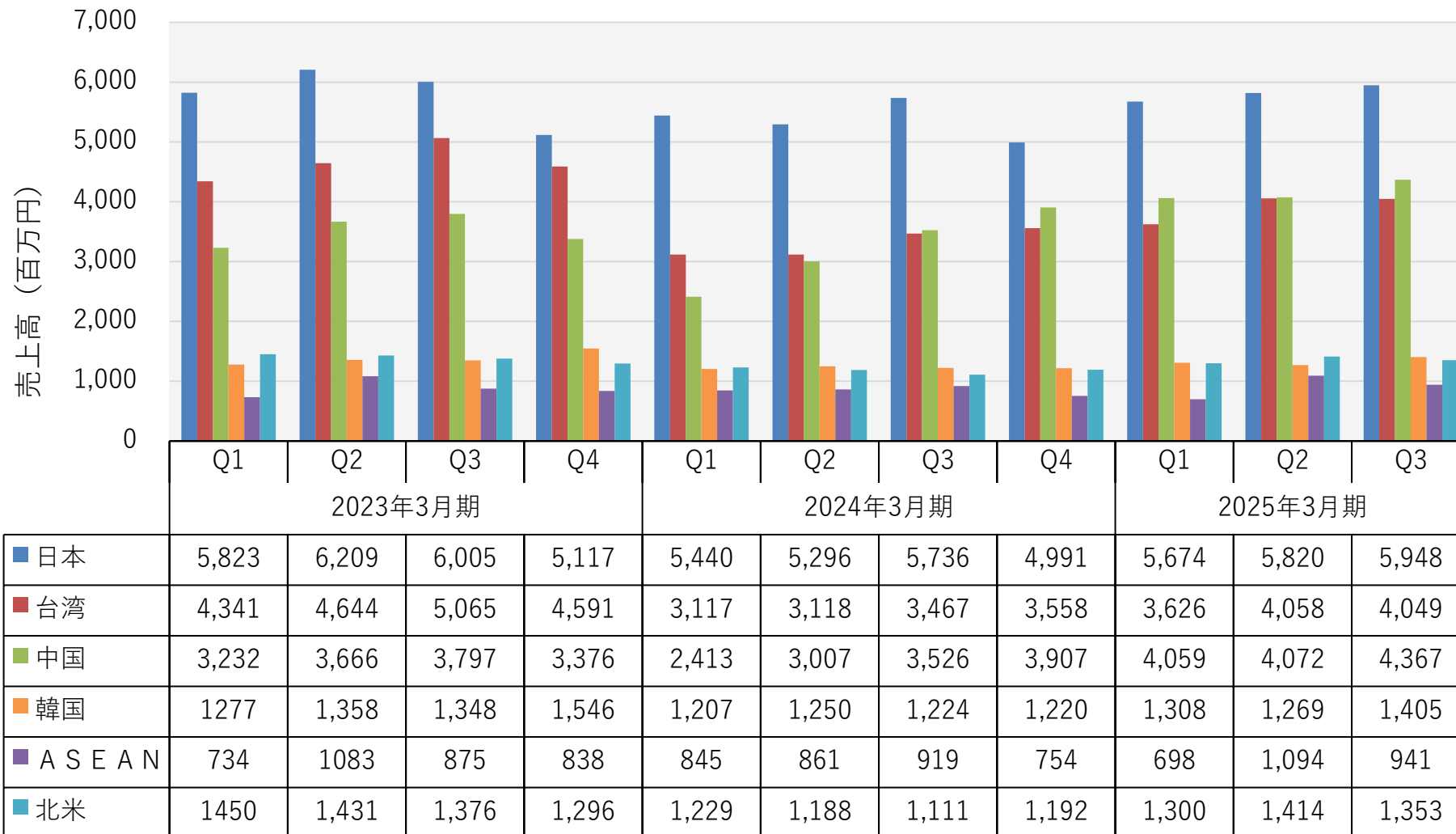


不動産賃貸事業



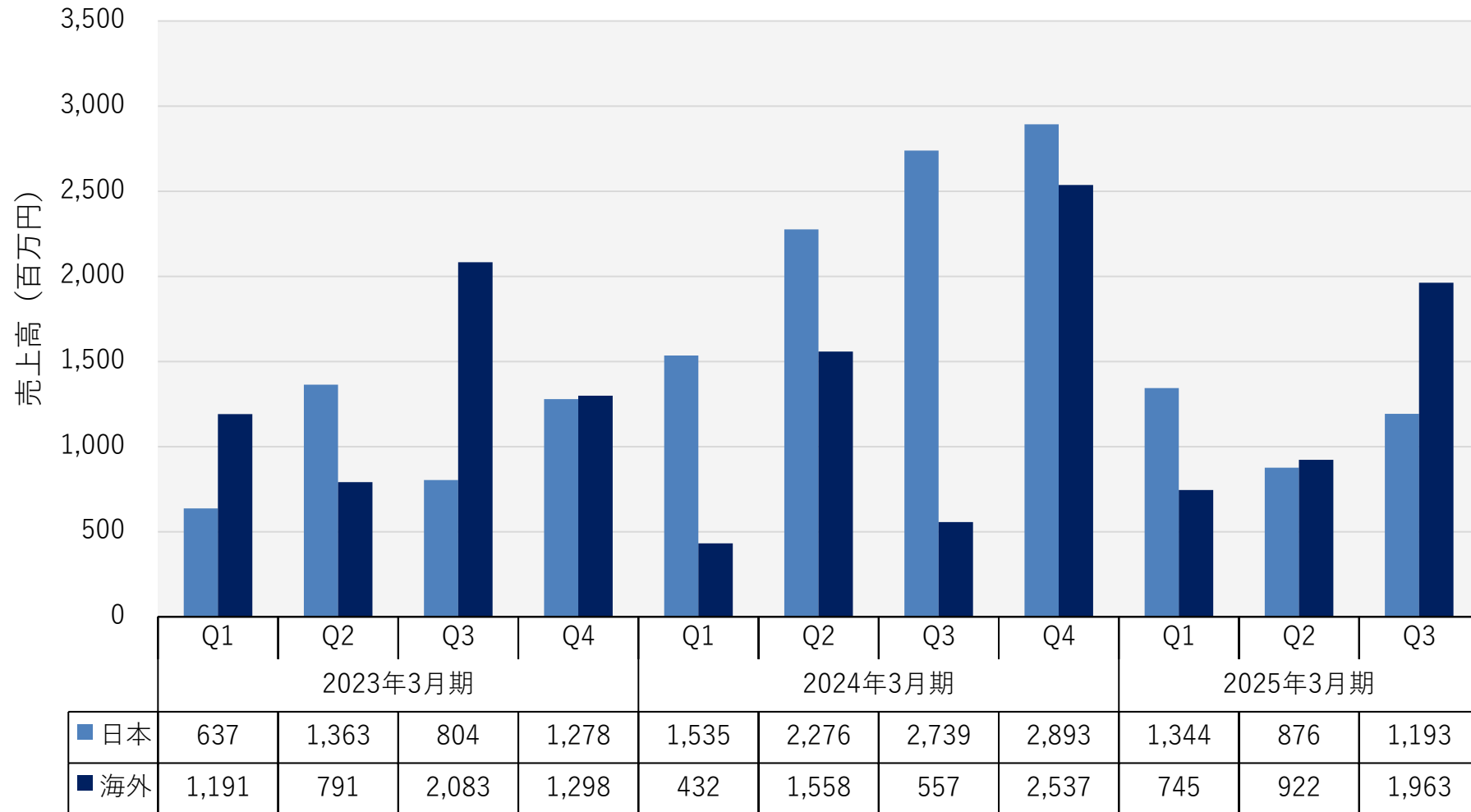
(単位：百万円)	前第3四半期 累計実績	当第3四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	8,677	13,665	4,988	57.5%
表面処理用機械	1,220	503	△ 717	△ 58.8%
めっき加工	△ 230	△ 27	203	-
不動産賃貸	380	365	△ 15	△ 3.9%

# 表面处理用資材事業 売上高推移

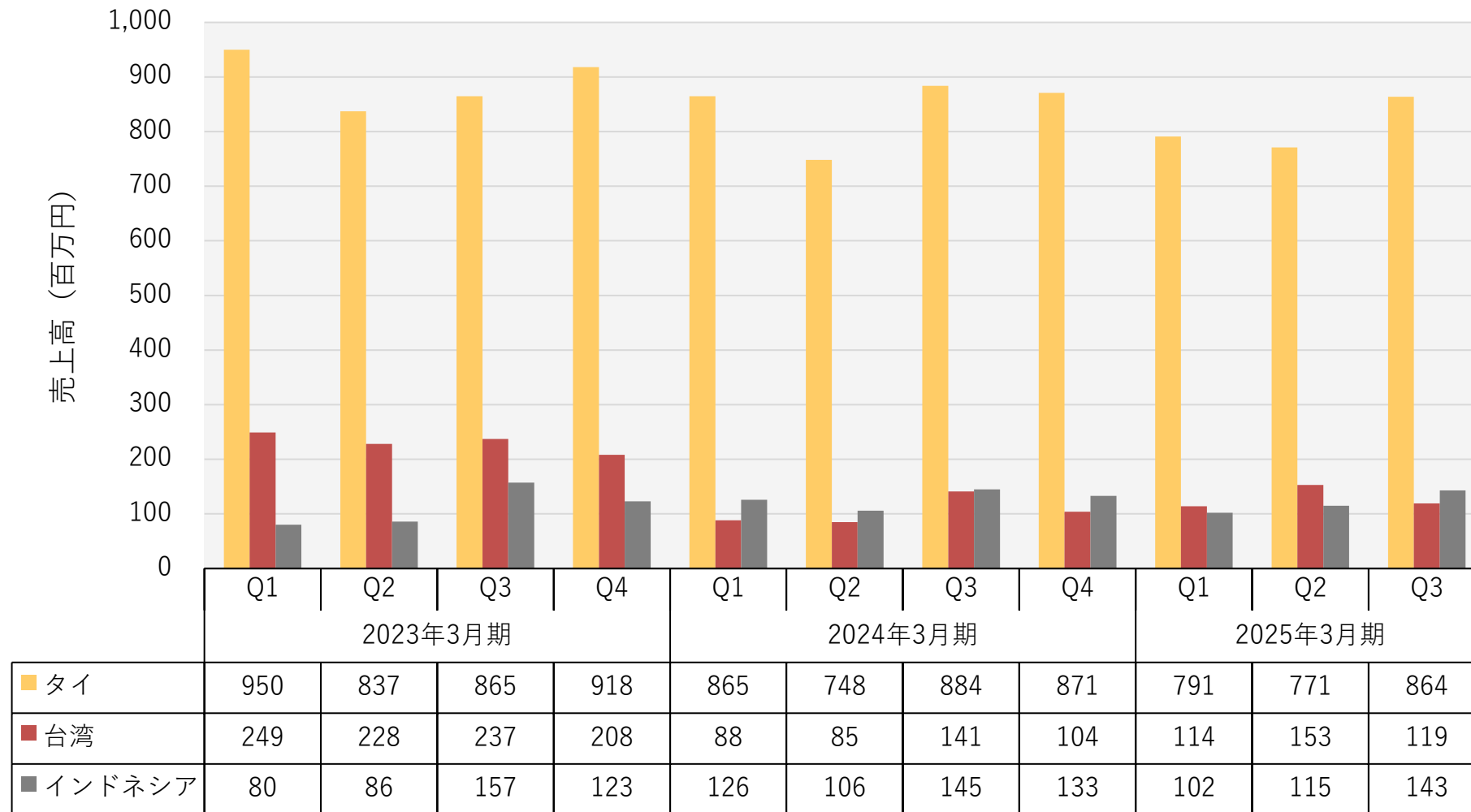




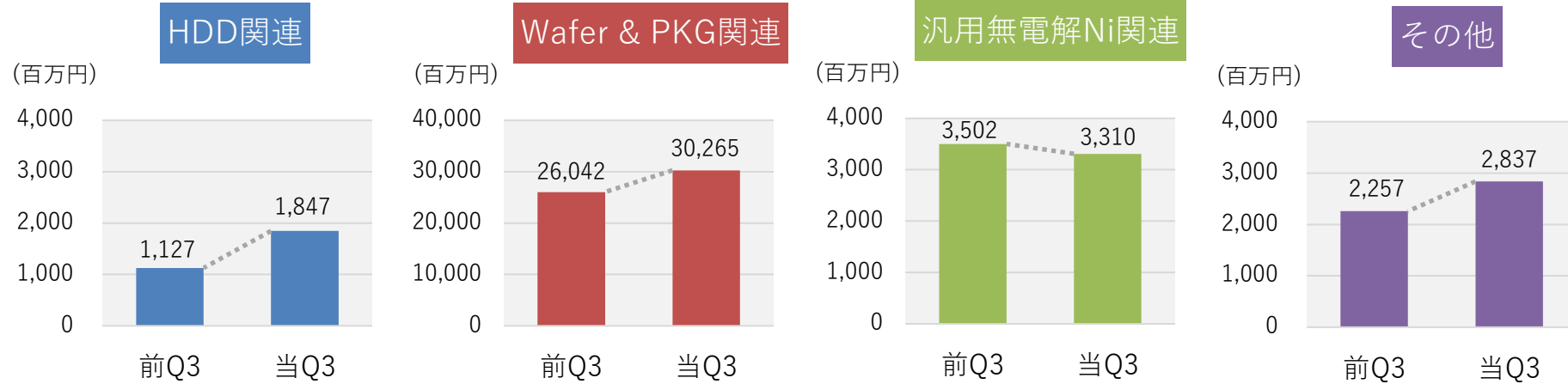
# 表面处理用機械事業 売上高推移



# めっき加工事業 売上高推移



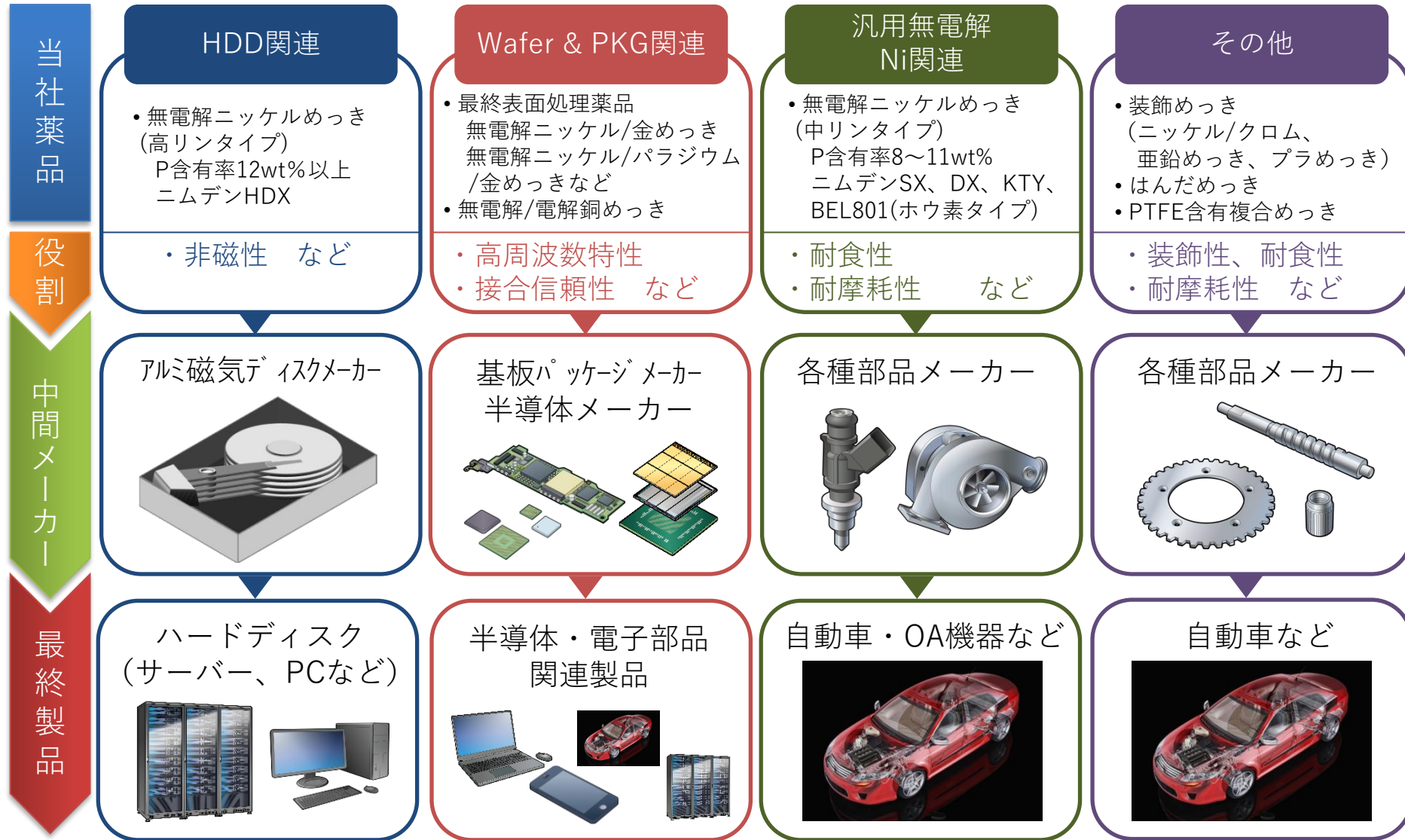
# 薬品カテゴリー別売上高



(単位：百万円)	前第3四半期累計実績		当第3四半期累計実績		増減額	増減率
		構成比		構成比		
HDD関連	1,127	3.4%	1,847	4.8%	719	+ 63.8%
Wafer & PKG関連	26,042	79.1%	30,265	79.1%	4,223	+ 16.2%
汎用無電解Ni関連	3,502	10.6%	3,310	8.7%	△ 192	△ 5.5%
薬品その他	2,257	6.9%	2,837	7.4%	579	+ 25.7%
合計	32,930	100.0%	38,260	100.0%	5,330	+ 16.2%

薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

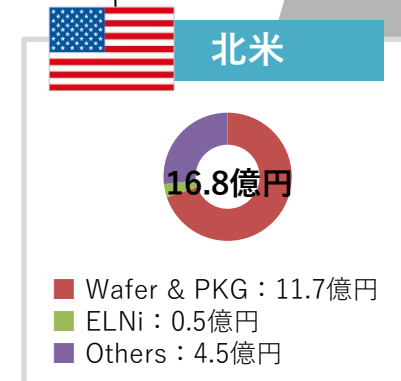
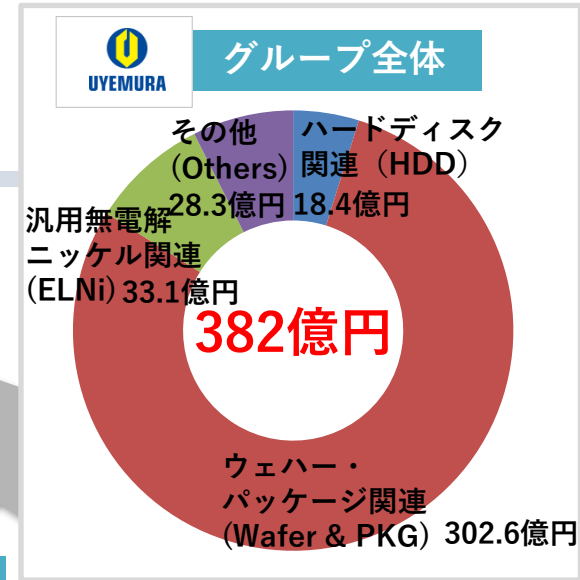
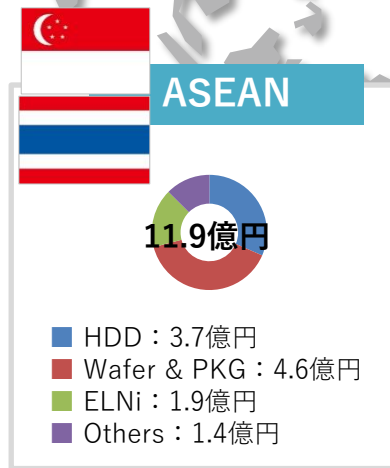
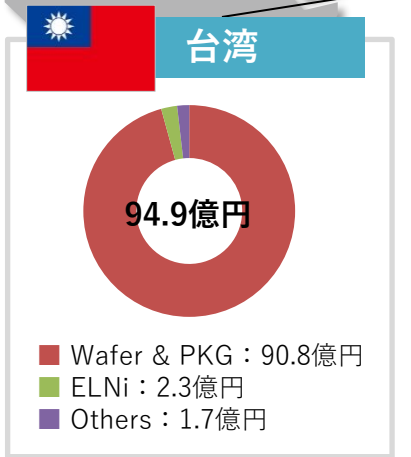
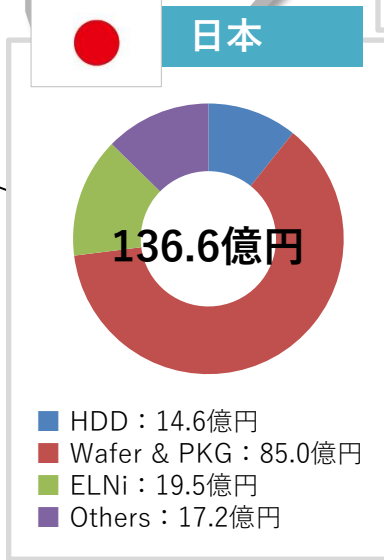
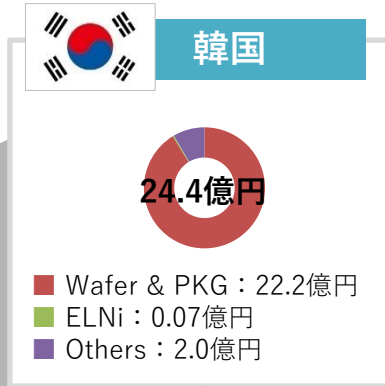
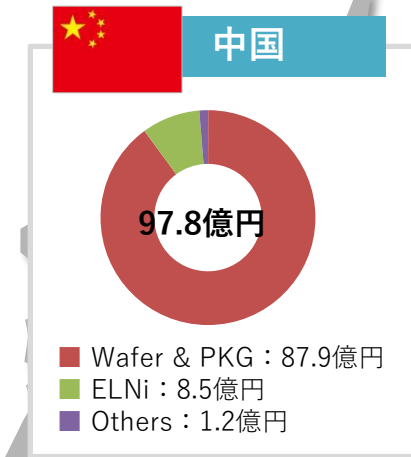
# 薬品ビジネス 最終製品までの流れ



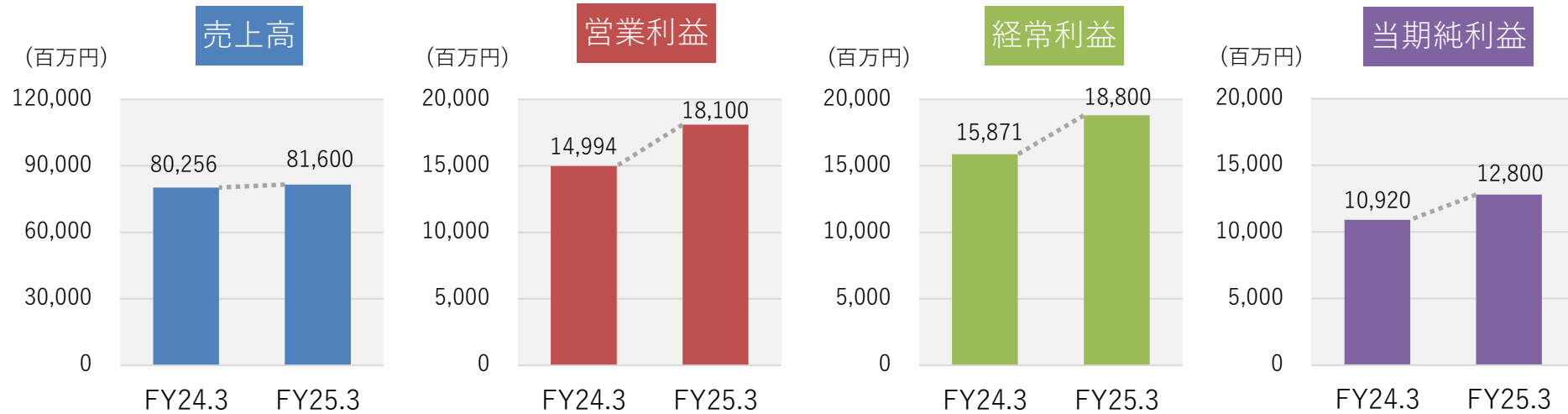
# 地域別薬品売上高

2025年3月期 第3四半期累計

※内部売上高含む



# 2025年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	増減額	増減率
売上高	80,256	81,600	+ 1,344	+ 1.7%
営業利益	14,994	18,100	+ 3,106	+ 20.7%
経常利益	15,871	18,800	+ 2,929	+ 18.5%
当期純利益	10,920	12,800	+ 1,880	+ 17.2%
為替：米ドル	140.67円	151.41円	10.74円安	

# 2025年3月期 通期業績予想

## ● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q3 累計実績	対予想 進捗率	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q3 累計実績	対予想 進捗率
表面処理用資材	60,583	68,296	52,463	76.8%	12,477	17,480	13,665	78.2%
表面処理用機械	14,528	8,193	7,045	86.0%	2,421	386	503	130.3%
めっき加工	4,298	4,329	3,175	73.3%	△ 346	△ 85	△ 27	-
不動産賃貸	824	815	621	76.2%	422	384	365	95.1%

## ● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2024.11.11修正)	当Q3 累計実績	対予想 進捗率
HDD関連	1,772	2,600	1,847	71.0%
Wafer & PKG関連	36,153	40,000	30,265	75.7%
汎用無電解Ni関連	4,796	4,400	3,310	75.2%
薬品その他	3,253	3,855	2,837	73.6%
合計	45,975	50,855	38,260	75.2%

<参考> 為替感応度

2025年3月期想定レート：151.41円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約370百万円増
- ・ 営業利益：約70百万円増

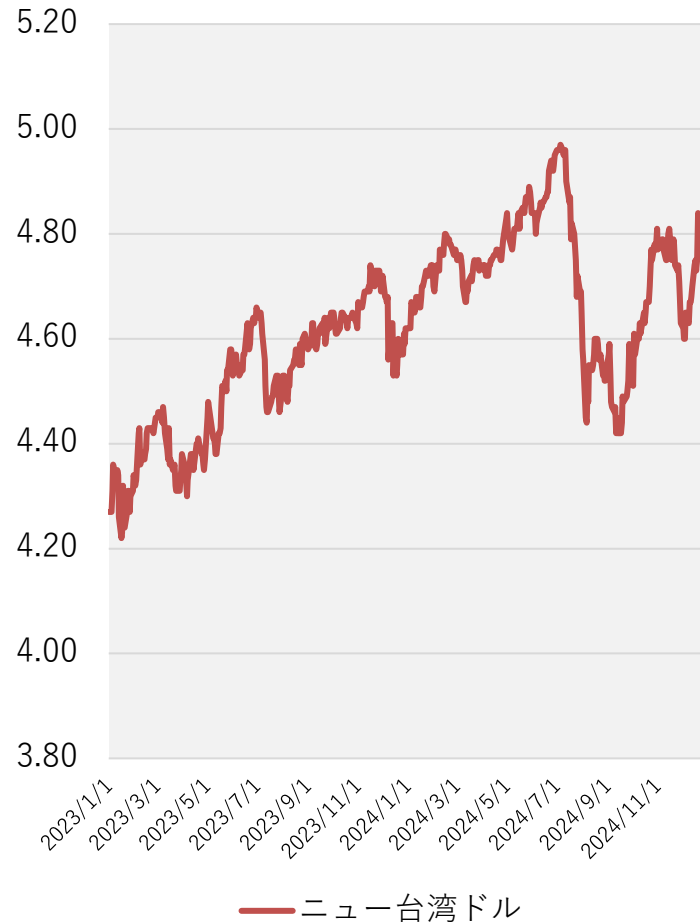
円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約370百万円減
- ・ 営業利益：約70百万円減

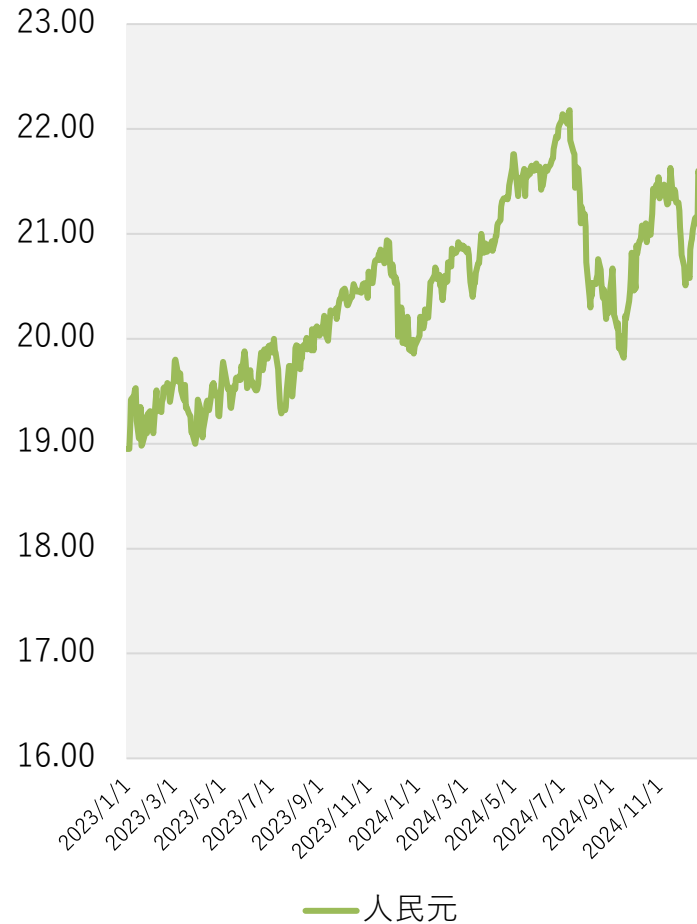
※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

# 為替レートの推移

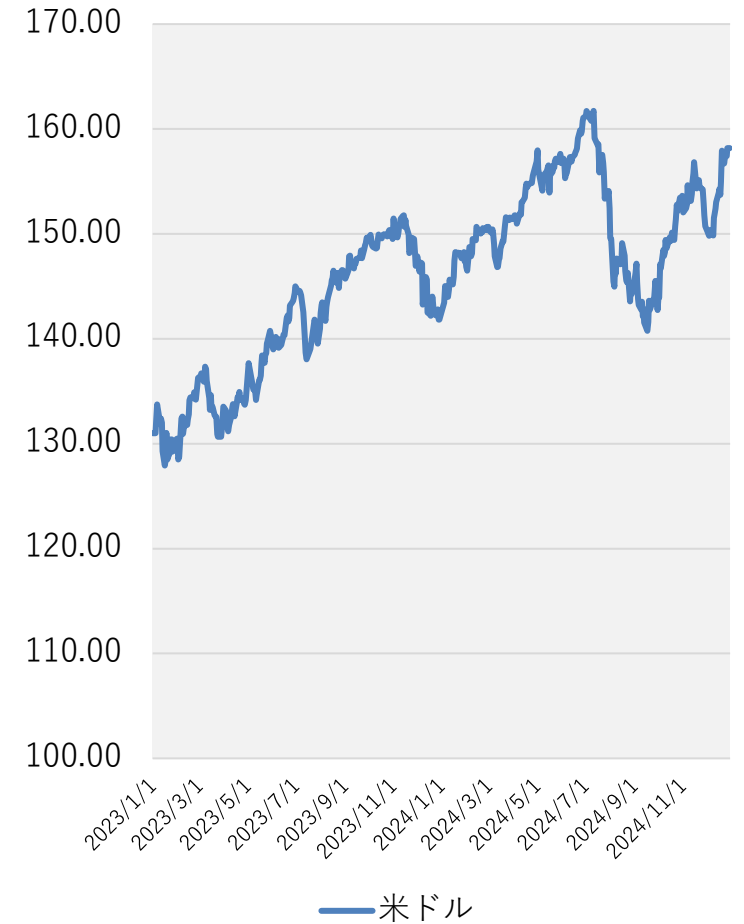
## ニュー台湾ドル



## 人民元

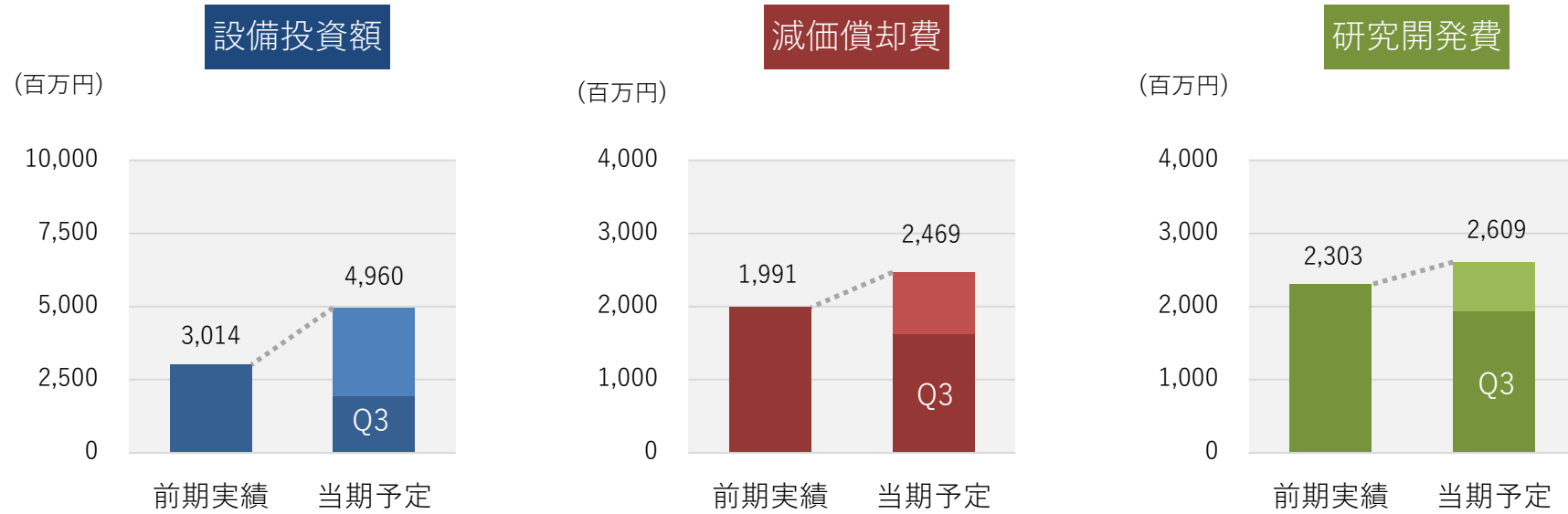


## 米ドル





# 設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	前期実績 (通期)	当第3四半期 累計実績	当期予定 (通期)
設備投資額	3,014	1,935	4,960
減価償却費	1,991	1,625	2,469
研究開発費	2,303	1,946	2,609

安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針とした配当政策に取り組んでいます

1株当たり配当金  
**200**円以上  
を維持

- 配当の下限值設定による安定した配当の実現
- 企業価値向上につながる研究開発設備の充実や半導体分野への投資の拡充

# 参考資料

---

## 顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供

## トータルソリューションシステム Total Solution for Plating Technologies

### めっき用薬品

素材の表面に金属の薄膜を形成し、様々な機能性や装飾性を与えるための薬品

### めっき用装置

大量の素材や難めっき素材に対するめっき工程を効率的に進めるための装置

### 液管理装置

めっき薬品の状態を常時分析し、薬液の補給を行うための装置

### めっき加工

グループ会社ではウエムラ製のめっき用薬品や装置を使用しためっき加工工場を保有



▶当社は表面処理の事業分野である、めっき用薬品、めっき用装置、液管理装置の3つすべてを手掛けています。

またタイ・台湾・インドネシアのグループ会社にめっき加工の工場を保有し、ウエムラ製のめっき用薬品や装置を使用して、日々の生産を行っています。つまりめっき加工工場はウエムラ製品を扱ったモデル工場となっており、現場で実践的なノウハウを蓄積し、製品開発へのフィードバックにつなげています。

- **電子部品/半導体**

**自動車関連**で、電動車が一段落した状態ですが、燃料自動車およびHybrid車の台頭で自動車全体としては活況を維持しています。更に自動運転補助システム採用車の増加で、多くの電子部品・半導体が自動車に使用されています。この流れで数多くの部品、半導体および各種センサーが自動車に搭載されています。また、レベル4自動運転を実現するには更に多くの電子部品が必要とされています。

**情報処理機器関連**で、AI SERVERが飛躍的に増加しています。当該SERVERの記憶媒体にアルミ・ハードディスクが使用されています。アルミ・ハードディスクの表面処理に無電解Niが採用されており、アルミ・ハードディスク用無電解Ni出荷量は順調に伸びています。当面はSSD(ソリッド・ステート・ドライブ)がアルミ・ハードディスクに変わる事はないと考えています。

- **表面処理装置**

コロナ特需の関係にて国内外有機パッケージ供給企業にて数多くのFC-BGA関連めっき設備が増強が実施されましたので、FC-BGA関連めっき設備需要は一段落すると考えています。反面、自動車向けパワー半導体関連設備は今後も必要とされていますので、自動車向けパワー半導体めっき設備は継続的に増強されていくと予想しています。有機PKG接合方式の変化でBUMP用めっき設備が若増加してくる可能性はあると考えてもいます。どちらにしましても継続的に新規めっき装置の開発は継続していますので、更なる品質向上が実現できる装置の開発および改良は継続して行きます。

- **当社が関係する原料**

**原材料の高騰および原油価格の高騰**：全ての原材料および部品そして燃料はロシア・ウクライナ問題およびコロナの影響で高騰している。当然、為替の影響も大きい。自動車向けパワー半導体および自動運転を補助する電子部品等に、表面処理薬品は大きな需要があると期待している。また、多くの薬品原料は為替等の影響で高騰しているものの、我々は企業努力で極力吸収する努力は継続している。自社努力だけで吸収できない貴金属、相場に連動した金属と原料および急激な価格高騰で自社努力だけでは吸収できない原料などは価格協力をお願いしている。めっき装置関連部材は比較的順調に入手は可能になっているが、クリーン・ルーム等で使用される半導体装置用原料の一部は未だに入手困難な状態である。



当社は「Growing together with  (:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています

## Environment (環境)

環境対応型製品・技術の開発・拡販



社会発展・環境改善へとつながる製品の開発・提供



廃棄物・水使用量の削減



クリーンエネルギーの使用、電力使用量の削減



持続可能な  
社会の実現

## Social (社会)

社会貢献・地域貢献活動の推進



受注から出荷までの工程の自動化

いきいきと働ける職場環境の整備



## Governance (ガバナンス)

コンプライアンスの徹底、人権の尊重

































BCP (事業継続計画) の実施



詳細な取り組み内容については、当社ホームページをご確認ください



# グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

# Growing together with



## Uyemura Group Companies

- |             |                                             |             |                                           |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| ● Japan     | C.Uyemura & Co., Ltd.                       | ● Taiwan    | Taiwan Uyemura Co., Ltd.                  |
| ● USA       | Uyemura International Corporation           | ● Korea     | Uyemura Korea Co., Ltd.                   |
| ● Hong Kong | Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd. | ● Singapore | Uyemura International (Singapore) Pte Ltd |
| ● Shenzhen  | Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd.                | ● Malaysia  | Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd.              |
| ● Shanghai  | Uyemura (Shanghai) Co., Ltd.                | ● Thailand  | Sum Hitechs Co., Ltd.                     |
|             |                                             | ● Indonesia | PT. Uyemura Indonesia                     |